



日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日

Date of Application:

2000年 2月25日

出願番号

Application Number:

特願2000-048670

出願人

Applicant(s):

株式会社ニコン

2001年12月 7日

Commissioner,
Japan Patent Office

及川耕造

【書類名】 特許願
 【整理番号】 99-00658
 【あて先】 特許庁長官殿
 【国際特許分類】 H01L 21/027

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内 3 丁目 2 番 3 号 株式会社 ニコ
 ン内

【氏名】 神谷 三郎

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内 3 丁目 2 番 3 号 株式会社 ニコ
 ン内

【氏名】 桂 公一

【発明者】

【住所又は居所】 東京都千代田区丸の内 3 丁目 2 番 3 号 株式会社 ニコ
 ン内

【氏名】 長橋 良智

【特許出願人】

【識別番号】 000004112

【氏名又は名称】 株式会社 ニコン

【代理人】

【識別番号】 100102901

【弁理士】

【氏名又は名称】 立石 篤司

【電話番号】 042-739-6625

【先の出願に基づく優先権主張】

【優先権主張の国】 日本

【優先権主張の番号】 特願 2000-048670

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 053132

特 2 0 0 0 - 0 4 8 6 7 0

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9408046

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 露光装置及びデバイス製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 所定のパターンを基板に転写する露光装置本体が収納され、その内部の環境条件がほぼ一定に維持される本体チャンバと、前記本体チャンバ内の空調を行う空調装置が収納された機械室とを備えた露光装置において、

前記本体チャンバから前記機械室に戻る排気経路の一部に配置された第 1 の化学物質除去フィルタを備えることを特徴とする露光装置。

【請求項 2】 前記機械室には、外気の取り入れ口が設けられ、該外気取り入れ口から取り入れられる空気の通路に配置された第 2 の化学物質除去フィルタを更に備えることを特徴とする請求項 1 に記載の露光装置。

【請求項 3】 前記機械室から前記本体チャンバ内の給気経路に至る経路の一部に配置された第 3 の化学物質除去フィルタを更に備えることを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載の露光装置。

【請求項 4】 前記第 3 の化学物質除去フィルタは、前記機械室と前記本体チャンバ内の給気経路との接続部に配置されていることを特徴とする請求項 3 に記載の露光装置。

【請求項 5】 前記本体チャンバ内の給気経路は、前記第 3 の化学物質除去フィルタの下流側で複数の経路に分岐されていることを特徴とする請求項 3 又は 4 に記載の露光装置。

【請求項 6】 前記本体チャンバ内の給気経路の本体チャンバ内部空間に対する空気の噴き出し口の近傍には、パーティクル除去用のエアフィルタが設けられていることを特徴とする請求項 3 ～ 5 のいずれか一項に記載の露光装置。

【請求項 7】 前記第 3 の化学物質除去フィルタより下流の前記給気経路部分は、脱ガスの少ない素材によって形成されていることを特徴とする請求項 3 ～ 5 のいずれか一項に記載の露光装置。

【請求項 8】 前記空調装置は、前記機械室を流通する排気を冷却する冷却装置と、この冷却された空気を加熱する加熱装置とを含み、

前記冷却装置の表面温度を、結露が発生しない程度の温度に制御する制御装置

を更に備えることを特徴とする請求項 1 ～ 7 のいずれか一項に記載の露光装置。

【請求項 9】 所定のパターンを基板に転写する露光装置本体が収納され、その内部の環境条件がほぼ一定に維持される本体チャンバと、前記本体チャンバ内の空調を行う空調装置が収納された機械室とを備えた露光装置において、

前記空調装置は、前記機械室内を流通する空気を冷却する冷却装置と、この冷却された空気を加熱する加熱装置とを含み、

前記冷却装置の表面温度を、結露が発生しない程度の温度に制御する制御装置を備えることを特徴とする露光装置。

【請求項 1 0】 前記基板表面には、感光剤として化学増幅型レジストが塗布されていることを特徴とする請求項 1 ～ 9 のいずれか一項に記載の露光装置。

【請求項 1 1】 マスクのパターンを基板上に転写する露光装置本体が収納された露光室と；

前記露光装置本体に対して前記基板を搬入し、かつ前記露光装置本体から前記基板を搬出する基板搬送系が収納された基板搬送系収納室と；

前記露光室に隣接し、かつ前記基板搬送系収納室の上方に配置され、その内部に前記露光装置本体に対して前記マスクを搬入し、かつ前記露光装置本体から前記マスクを搬出するマスク搬送系が収納されたマスク搬送系収納室とを備え、

前記マスク搬送系収納室の前記露光室との境界部分に、前記露光室内に供給される空調用気体の噴き出し口が設けられていることを特徴とする露光装置。

【請求項 1 2】 前記噴き出し口の前記マスク搬送系収納室側にパーティクル除去用のエアフィルタが配置されていることを特徴とする請求項 1 1 に記載の露光装置。

【請求項 1 3】 前記露光室、前記基板搬送系収納室、及び前記マスク搬送系収納室が、別々の環境制御チャンバによって構成されていることを特徴とする請求項 1 1 に記載の露光装置。

【請求項 1 4】 前記露光装置は、前記露光室内に供給される空調用気体の噴き出し口が設けられていることを特徴とする請求項 1 1 に記載の露光装置。更に、前記露光室内に供給される空調用気体の噴き出し口が設けられていることを特徴とする請求項 1 1 に記載の露光装置。

【請求項 1 5】 前記空調装置は、前記空調用気体を冷却する冷却装置を有

前記冷却装置の表面温度を、結露が発生しない程度の温度に制御する制御装置を更に備えることを特徴とする請求項 14 に記載の露光装置。

【請求項 17】 前記露光装置本体を構成する基板ステージと前記基板ステージの位置を計測する干渉計が配置される、前記露光室内の一部空間を、前記空調装置とは独立に空調する別の空調装置を更に備えることを特徴とする請求項 16 に記載の露光装置。

【発明の詳細な説明】

【発明の属する技術分野】

【 0 0 0 2 】

半導体露光装置等の微細加工を行なう装置では、極めて高精度に温度調節をする必要があることから、その温度調節のために空調部が設けられているが、例えば、設定温度に対し $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ の範囲という極めてシビアな温度調節を行う必要

【○○○3】

L S I 等の電子デバイスを製造する露光装置においては、装置内部の清浄度を保つ必要から、レチクル、投影レンズ等から成る露光装置本体が収納された本体チャンバ内部の圧力は当該本体チャンバ外より常に陽圧にする必要がある。この本体チャンバ内外の圧力差により本体チャンバ内の空気が外部に漏れ、その漏れ分を外部から供給する必要がある。このため、本体チャンバに対する空気の供給経路（給気経路）の一部にはO A (Outside Air inlet) 口と呼ばれる外気取り入れ口が設けられ、通常このO A 口を介して外気の取り入れが自然吸気で行われるようになっている。

【 0 0 0 4 】

一方、本体チャンバからの戻り空気は、外部からの供給空気と一緒に機械室内の空調装置に入る。空調装置に入った空気は、まずクーラーによって冷却され、外気取り入れによって外部からもたらされた余分な水分が放熱フィンで結露し、除かれる。その後ヒーターで所望の温度まで昇温され、送風ファンで本体チャンバ内に送り込まれる。

【 0 0 0 5 】

ところで、最近になってクリーンルーム雰囲気中の微量ガスが、縮小投影型露光装置等の半導体製造装置に対して悪影響をもたらすことが判ってきた。これを具体的に説明すると、K r FあるいはA r Fなどのエキシマレーザをその光源に用いたエキシマレーザ露光装置やX線露光装置や電子ビーム露光装置等では、各光源の輝度が不足するのにレジストの高感度で対応しようとの観点から、レジスト中の感光剤として酸発生剤を含み、露光で発生した酸により、続く熱処理（P E B）において触媒反応が誘起され、現像液に対して不溶化（ネガ型）又は可溶化（ポジ型）が促進される、高感度の化学増幅型レジスト（chemically amplified resist）が用いられるが、例えば、ポジ型レジストの場合、雰囲気中のp p bレベルの微量な塩基性ガスが、当該ポジ型化学増幅型レジストの表面に発生し

（特開2000-048670号公報）

（特開2000-048670号公報）

しまう現象が生ずる。そのままでは高感度レジストである化学増幅型レジストが用いられないので、オーバーコート等を行わなければならないかたたりして、スル

ーputが低下することになる。

【 0 0 0 6 】

また、露光光の短波長化、高照度化に伴い、照明系部材の表面に雰囲気中の微量ガスが曇り物質として析出するという問題も発生している。これは雰囲気中の微量ガスと露光光の間の光化学反応により生じるものである。反応物質としては、空気中のアンモニアガスや硫黄酸化物、有機珪素化合物等が対象として挙げられている。照明系部材の曇り発生の結果として、照度低下が顕著となり、スルーputが低減してしまう。

【 0 0 0 7 】

そのため、これらのクリーンルーム雰囲気中の微量な不純物ガスを除去する手段として特開平 6 - 7 7 1 1 4 号の発明等が提案されている。

【 0 0 0 8 】

ところで、従来の露光装置では、露光装置本体とウエハ等の感光基板を搬送する基板搬送系ないしマスク搬送系とを1つの環境制御チャンバ内に収納する方式と、露光装置本体と基板搬送系ないしマスク搬送系とを別個の環境制御チャンバ内に収納する方式とが知られている。

【 0 0 0 9 】

いずれの方式の場合にも、露光装置が収納された露光室内部を、基板搬送系ないしはマスク搬送系が設置された側面とは別の側面方向から横方向に送風（サイドフロー）するか、露光室内の天井側から床面側に向けて縦方向下向きに送風（ダウフロー）するかのいずれかの手法が採用されていた。

【 0 0 1 0 】

【発明が解決しようとする課題】

上記公報に記載の発明によれば、クリーンルーム雰囲気中の微量な不純物ガスはある程度除去することができ、光学材料の曇りによる照度低下や化学増幅型レ

しかし、最近では、半導体素子の微細化に伴い、従来問題とならなかった露光装置で用いられる接着剤、シーリング剤、塗料や各構成部材そのものからの脱ガ

スが無視できなくなってきており、露光装置本体そのものが汚染源であると言える。今や、これらの脱ガスの影響を取り除くため、露光装置の内部は、ケミカル的にもクリーンであることが要請され、上記公報に記載の発明と同様に、露光装置内に化学物質除去用のケミカルフィルタを設置することは、今や常識となっている。

【 0 0 1 2 】

しかしながら、上記公報に記載の発明と同様、従来の露光装置では、外気取り入れ口や本体チャンバの内部空間に対する空気の供給路側のみに不純物除去用フィルタが設けられていることから、露光装置本体の空調を行ってその露光装置本体から発生する脱ガスを含むケミカル的に汚れた空気がそのまま空調機側に戻り、その空調機の送風ファンによって空気の供給路側に設けられたケミカルフィルタに送り込まれる。このため、その供給路側のケミカルフィルタの寿命が著しく短くなって、そのケミカルフィルタを頻繁に交換しなければならない。また、従来の露光装置の設計では、装置の寿命のある間は、ケミカルフィルタの交換は不要であることを前提としていたことから、外気取り入れ口以外のケミカルフィルタは交換し難い場所に設けられているのが通常であり、このため、交換に長時間を要してしまう。また、このケミカルフィルタの交換のため、長時間に渡ってチャンバの扉を開放しなければならないことから、装置外のクリーンルーム内のケミカル的にクリーンでない空気が装置内に混入し、内部空間のクリーン度を高く維持することが困難になる。

【 0 0 1 3 】

また、従来の露光装置では、温度調節上、ドレインの配管は必要不可欠であり、このドレイン配管によって装置の空調部が外部に開放されている。また、装置の構成上ヒーターやクーラーは送風ファンの直前に置かれることが多く、送風ファンの特性上ドレインパンでは外気に対して陰圧（ -3 hPa ぐらい）になって

【 0 0 1 4 】

a. ドレイン配管は、半導体製造工場内の他のデバイス機器と最終的に結合し

ており、ドレインパンでは外気に対して陰圧になっているので、ドレインパンに水が溜まっていないときには、他の製造装置由来の不純物ガスがドレイン配管によって装置内に流入してくる可能性がある。

b. 他の製造装置で行われるアルカリ処理や酸性処理等の化学的な工程によって各装置雰囲気内に発生した化学物質が各装置の温調排水に溶解込むことが微視的レベルで発生している。それらの化学物質がドレイン配管によって露光装置内に p p b レベルで流入してくる可能性はかなり大きい。配管系が特に高濃度の化学物質を含む排水でない限り、特に化学的な装置汚染に配慮がなされていない場合が多く、温調排水の配管系は、装置外のクリーンルーム雰囲気と繋がっている場合も有り得る。

c. ドレインパンには、装置の設置条件によっては、常にクーラーでの結露水が溜まっていることがあり、その場合には工場配管から直接外気が装置内に混入されることは無いが、溜まっている結露水を介在して間接的に混入してくる可能性があり、いずれにしても問題となる。

d. 工場配管の影響が小さい場合でも、ドレインパンに結露水が溜まっている場合、陰圧の影響で長時間流れ出ることがないため、循環している空気中の微量ガスが溶解し、濃縮された後、微生物等が繁殖したりして、露光装置に悪影響をもたらすガスの 2 次供給源となる可能性がある。

【 0 0 1 5 】

一方、露光室内の空調方式については、例えば、前述した従来のサイドフロー方式を採用する露光装置の場合、露光室の左右前後の 4 面の内、基板搬送系ないしマスク搬送系が設置される側の側面、露光室内に空調用気体を送り込むための噴き出し口（送風口）が設けられる側面、更に場合によってはこれらに加えて空調機が設置される機械室が配置される側面の 2 面あるいは 3 面が必然的に塞がれるため、露光装置本体に対するメンテナンスを、所定の 2 方向のいずれか、又は

両方向から行う必要があり、これは、メンテナンス作業に困難を伴うという不都合があった。

【 0 0 1 6 】

これに対し、前述した従来のダウンフロー方式を採用する露光装置の場合、基板搬送系ないしマスク搬送系が設置される側の側面以外の側面、あるいはこの側面と機械室が配置される側の面以外の3面あるいは2面側から露光装置本体に対するメンテナンス作業を行うことができる。しかしながら、この方式の露光装置では、露光室の天井部分に除塵用フィルタ（エアフィルタ）やケミカルフィルタ、及び除塵用フィルタのプレナム・ダクトを設置する必要があることから露光装置の全高が高くなり、露光装置が設置される高価なクリーンルーム（工場）の天井の高さを高くしなければならず、設備コストの上昇を招く等の不都合があった。

【 0 0 1 7 】

本発明は、かかる事情の下になされたもので、その第1の目的は、光学材料の曇りによる照度低下等の弊害の発生を長時間に渡って効果的に抑制することができる露光装置を提供することにある。

【 0 0 1 8 】

本発明の第2の目的は、良好なメンテナンス性を確保しつつ、装置全高を低くすることができる露光装置を提供することにある。

【 0 0 1 9 】

また、本発明の第3の目的は、高集積度のマイクロデバイスを生産性良く製造することができるデバイス製造方法を提供することにある。

【 0 0 2 0 】

【課題を解決するための手段】

請求項1に記載の発明は、所定のパターンを基板（W）に転写する露光装置本体が収納され、その内部の環境条件がほぼ一定に維持される本体チャンバ（12）と、前記本体チャンバ（12）内の空調を行う空調装置が収納された機械室（14）とを備えた露光装置において、前記本体チャンバから前記機械室に戻る排

気路を設け、

【 0 0 2 1 】

ここで、1つのチャンバを隔壁により仕切って露光装置本体が収納される本体

チャンバと機械室とを形成しても良いが、機械室内の空調装置に起因する振動を考慮すれば、本体チャンバとは分離して機械室を配置するのが通常である。しかしながら、振動の問題は、他の手段で解決が可能であるので、本発明の機械室は、上記のいずれの構成をも含む。

【 0 0 2 2 】

これによれば、本体チャンバから機械室に戻る排気経路の一部に配置された第 1 の化学物質除去フィルタを備えることから、露光装置本体で発生した脱ガスに起因する汚染物質を第 1 の化学物質除去フィルタでほぼ確実に除去することができ、しかもこの第 1 の化学物質除去フィルタは本体チャンバから機械室に戻る排気経路の一部に配置されているので、非常に交換が容易である。従って、本発明によれば、本体チャンバ内を化学的に清浄度の高い状態（ケミカルクリーンな状態）に保つことができ、これにより光学材料の曇りによる照度低下等の弊害の発生を長時間に渡って効果的に抑制することが可能になる。

【 0 0 2 3 】

この場合において、請求項 2 に記載の発明の如く、前記機械室（14）には、外気取り入れ口（50）が設けられ、該外気取り入れ口から取り入れられる空気の通路に配置された第 2 の化学物質除去フィルタ（CF2）を更に備えていても良い。かかる場合には、外気取り入れ口からクリーンルーム内の空気が装置内に取り入れられるが、その取り入れられる空気の通路に第 2 の化学物質除去フィルタが設けられているので、結果的に化学的にクリーンな外気が装置内に取り入れられることとなり、装置内のクリーン度を低下させることがない。このため、本体チャンバ内を外気に対して陽圧にして清浄度を高く保つことが可能である。

【 0 0 2 4 】

上記請求項 1 及び 2 に記載の各発明に係る露光装置において、請求項 3 に記載の発明の如く、前記機械室（14）から前記本体チャンバ（12）内の給気経路

に備えられた送風機を介して、かかる場合には、機械室内の空調装置による温度調整された空気を、露光装置本体が収納された空間に送り込むのに先立って、再度その空気中の化学的な汚染物質を除去できるので、より一層化学的に清浄

度の高い（ケミカルクリーンな）空気により露光装置本体を空調でき、本体チャンバ内を一層クリーンな状態にすることができる。この第3の化学物質除去フィルタには、第1の化学物質除去フィルタ（及び第2の化学物質除去フィルタ）で化学的な汚染物質が除去されたケミカルクリーンな空気が送り込まれるので、その寿命が長くなり、長期間に渡って交換が不要である。

【 0 0 2 5 】

この場合において、請求項4に記載の発明の如く、前記第3の化学物質除去フィルタは、前記機械室（14）と前記本体チャンバ（12）内の給気経路（24）との接続部に配置されていても良い。かかる場合には、通常機械室と本体チャンバとは容易に分離できるので、その第3の化学物質除去フィルタは交換も容易である。

【 0 0 2 6 】

上記請求項3及び4に記載の各発明において、請求項5に記載の発明の如く、前記本体チャンバ内の給気経路は、前記第3の化学物質除去フィルタの下流側で複数の経路に分岐されていても良い。

【 0 0 2 7 】

上記請求項3～5に記載の各発明において、請求項6に記載の発明の如く、前記本体チャンバ内の給気経路の本体チャンバ内部空間に対する空気の噴き出し口の近傍には、パーティクル除去用のエアフィルタ（AF1～AF4）が設けられていることが望ましい。かかる場合には、露光装置をクリーン度がクラス100～1000程度の比較的クリーン度の低いクリーンルーム内に設置することができるので、クリーンルームの維持コストを低減することができる。

【 0 0 2 8 】

また、上記請求項3～5に記載の各発明において、請求項7に記載の発明の如く、前記第3の化学物質除去フィルタより下流の前記給気経路部分は、脱ガスの

物質除去、例えば、下流の給気経路部分で脱ガスが開始されないことにより、ケミカルクリーンな空気を露光装置本体に対して送り込むことができる。

【 0 0 2 9 】

請求項 1 ～ 7 に記載の各発明に係る露光装置において、請求項 8 に記載の発明の如く、前記空調装置は、前記機械室内を流通する空気を冷却する冷却装置（52）と、この冷却された空気を加熱する加熱装置（56、62）とを含み、前記冷却装置の表面温度を、結露が発生しない程度の温度に制御する制御装置（70）を更に備えていても良い。かかる場合には、制御装置により冷却装置の表面温度が結露が発生しない程度の温度に制御されるので、空調装置のドレイン配管系が不要となり、ドレイン配管系があることに起因する前述した a. ～ d. のような不具合の発生を阻止することができ、機械室及び本体チャンバ内を一層ケミカルクリーンな状態とすることができ、より一層長期に渡って光学材料の曇りによる照度低下等の弊害の発生をより効果的に抑制することが可能になる。

【 0 0 3 0 】

請求項 9 に記載の発明は、所定のパターンを基板（W）に転写する露光装置本体（22）が収納され、その内部の環境条件がほぼ一定に維持される本体チャンバ（12）と、前記本体チャンバ内の空調を行う空調装置が収納された機械室（14）とを備えた露光装置において、前記空調装置は、前記機械室内を流通する空気を冷却する冷却装置（52）と、この冷却された空気を加熱する加熱装置（56、62）とを含み、前記冷却装置の表面温度を、結露が発生しない程度の温度に制御する制御装置（70）を備えることを特徴とする。

【 0 0 3 1 】

これによれば、制御装置により冷却装置の表面温度が結露が発生しない程度の温度に制御されるので、空調装置のドレイン配管系が不要となり、ドレイン配管系があることに起因する前述した a. ～ d. のような不具合の発生を阻止することができ、これにより機械室及び本体チャンバ内をケミカルクリーンな状態とすることができ、長期に渡って光学材料の曇りによる照度低下等の弊害の発生を効果的に抑制することが可能になる。

前記請求項 1 ～ 7 に記載の各発明に係る露光装置において、請求項 11 に記載の発明の如く、前記基板表面には、感光剤として化学増幅型レジストが塗布されていても良い。かかる場合には、本体チャンバ内をケミカルクリーンな状態に維

持できるので、長期に渡って光学材料の曇りによる照度低下を抑制できるのに加え、化学増幅型レジストの表面難溶化現象を低減することができる。

【 0 0 3 3 】

ところで、近年、生産性を上げるため、基板（例えば、半導体素子製造の場合にはウエハ）の大型化が要求されている。特にマスクと比べた場合、基板側が大きくなる傾向にあり、露光装置においても、マスク搬送系に比べて基板搬送系が相対的に大きくなる傾向にある。かかる点に着目して、請求項 1 1 に記載の発明では、次のような構成を採用する。

【 0 0 3 4 】

すなわち、請求項 1 1 に記載の発明に係る露光装置は、マスク（R）のパターンを基板（W）上に転写する露光装置本体（2 2）が収納された露光室（1 6）と；前記露光装置本体に対して前記基板を搬入し、かつ前記露光装置本体から前記基板を搬出する基板搬送系（8 4、8 6、8 8）が収納された基板搬送系収納室（2 0）と；前記露光室に隣接し、かつ前記基板搬送系収納室の上方に配置され、その内部に前記露光装置本体に対して前記マスクを搬入し、かつ前記露光装置本体から前記マスクを搬出するマスク搬送系（8 0、8 2）が収納されたマスク搬送系収納室（1 8）とを備え、前記マスク搬送系収納室内の前記露光室との境界部分に、前記露光室内に供給される空調用気体の噴き出し口（9 0）が設けられていることを特徴とする。

【 0 0 3 5 】

これによれば、マスク搬送系収納室内の露光室との境界部分に、露光室内に供給される空調用気体の噴き出し口が設けられていることから、露光室の前後左右の 4 面の内、噴き出し口が設けられた面以外の 3 面側から露光室内の露光装置本体のメンテナンスが可能である。また、露光室内は、マスク搬送系収納室内の露光室との境界部分、すなわち露光室の上半部に設けられた噴き出し口から噴き出

る空調用気体によって、露光室内の露光装置本体のメンテナンスが可能である。従って、本発明によれば、良好なメンテナンス性を確保しつつ、装置全高を低くすることができる。この場合において、前記境界部分

に設けられた噴き出し口から噴き出される空調用の気体を用いて露光室内をダウンフローにより空調しても良いが、露光室内の上部空間をサイドフローにて送風しても良い。

【 0 0 3 6 】

上記請求項 1 1 に記載の発明において、請求項 1 2 に記載の発明の如く、前記噴き出し口の前記マスク搬送系収納室（1 8）側にパーティクル除去用のエアフィルタ（A F 3）を配置しても良い。前述の如く、マスク搬送系に比べて基板搬送系が相対的に大きくなる傾向にあるため、基板搬送系収納室に比べてマスク搬送系収納室には空間的に余裕があるので、エアフィルタを無理なく配置することができる。この場合、エアフィルタとともに、フィルタブレナム（送風された気体の動圧を静圧に変換し、エアフィルタから気体を均一に噴き出すようにする機能を持つ、フィルタの背面の室）を配置しても良い。このようにすると、噴き出し口から均一な気流を得ることができる。

【 0 0 3 7 】

上記請求項 1 1 に記載の発明に係る露光装置において、露光室、基板搬送系収納室、及びマスク搬送系収納室を同一の環境制御チャンバ内に設けても良いが、請求項 1 3 に記載の発明の如く、前記露光室、前記基板搬送系収納室、及び前記マスク搬送系収納室を、別々の環境制御チャンバによって構成しても良い

【 0 0 3 8 】

上記請求項 1 1 ～ 1 3 に記載の各発明に係る露光装置において、請求項 1 4 に記載の発明の如く、前記露光室からその空調装置に戻る前記空調用気体の排気通路に配置される化学物質除去フィルタを更に備えることとすることができる。かかる場合には、露光室からその空調装置に戻る空調用気体の排気通路に配置される化学物質除去フィルタを備えることから、露光装置本体で発生した脱ガスに起因する汚染物質を化学物質除去フィルタでほぼ確実に除去することができ、結果

として、露光装置の内部に発生する汚染物質の量を低減させることができる。また、これにより、光材材料の劣化、光の照度低下等の弊害の発生を長時間に渡って効果的に抑制することが可能になる。

【 0 0 3 9 】

この場合において、請求項 1 5 に記載の発明の如く、前記空調装置は、前記空調用気体を冷却する冷却装置を有し、前記冷却装置の表面温度を、結露が発生しない程度の温度に制御する制御装置を更に備えることとすることができる。かかる場合には、制御装置により冷却装置の表面温度が結露が発生しない程度の温度に制御されるので、空調装置のドレイン配管系が不要となり、ドレイン配管系があることに起因する前述した a. ～ d. のような不具合の発生を阻止することができ、結果的に露光室内を一層ケミカルクリーンな状態とすることができ、より一層長期に渡って光学材料の曇りによる照度低下等の弊害の発生をより効果的に抑制することが可能になる。

【 0 0 4 0 】

上記請求項 1 1 ～ 1 3 に記載の各発明に係る露光装置において、請求項 1 6 に記載の発明の如く、前記露光室、前記基板搬送系収納室、及び前記マスク搬送系収納室は、同一の空調装置（5 2、5 6、5 8）によって空調が行われるように、各室の給気通路及び排気通路が形成されていることが望ましい。かかる場合には、単一の空調装置のみを用いて効率良く、3 つの室の空調を行うことができる。

【 0 0 4 1 】

この場合において、請求項 1 7 に記載の発明の如く、前記露光装置本体（2 2）を構成する基板ステージ（W S T）と前記基板ステージの位置を計測する干渉計（I F）が配置される、前記露光室（1 6）内の一部空間を、前記空調装置とは独立に空調する別の空調装置（5 2、6 2、6 4）を更に備えていても良い。かかる場合には、この別の空調装置として温度制御性の高い空調装置を用いることにより、いわゆる空気揺らぎ（温度揺らぎ）に起因する干渉計の計測誤差を可能な限り抑制して、特に精度が要求される基板ステージの位置制御を要求される精度で実現することができる。ここで、別の空調装置は、前記空調装置と全く別

【 0 0 4 2 】

請求項 1 8 に記載の発明は、リソグラフィ工程を含むデバイス製造方法である。

【 0 0 4 3 】

【 0 0 4 4 】

【 0 0 4 5 】

【 0 0 4 6 】

【 0 0 4 7 】

出証特 2 0 0 1 - 3 1 0 7 2 2 3

は、これらレチクルライブラリ 8 0 とレチクルローダ 8 2 とによってマスク搬送系としてのレチクルローダ系が構成され、このレチクルローダ系が小部屋 1 8 に収納されている。そこで、以下においては、小部屋 1 8 を、レチクルローダ室 1 8 と呼ぶものとする。

【 0 0 4 8 】

なお、レチクルローダ系は、上記構成に限られるものではなく、例えば複数枚のレチクルを収納可能なボトムオープンタイプの密閉式カセット（コンテナ）をレチクルライブラリ 8 0 の代わりに用いても良いし、あるいはレチクルローダとして搬送アームをスライドさせる機構を用いても良い。また、レチクル保管部（レチクルライブラリ 8 0）とレチクルローダ 8 2 とを異なる部屋に配置しても良いし、あるいは前述の密閉式カセットをレチクルローダ室 1 8 の上部に載置し、その気密性を維持した状態でボトムオープンにてレチクルをレチクルローダ室 1 8 内に搬入するようにしても良い。要は、小部屋 1 8 にはレチクルローダのみが配置されていても良い。

【 0 0 4 9 】

また、他方の小部屋 2 0 は、その内部に、複数枚の基板としてのウエハを保管するウエハキャリア 8 4、ウエハキャリア 8 4 に対してウエハを出し入れする水平多関節型ロボット 8 6 及び該ロボット 8 6 と露光装置本体 2 2 を構成するウエハステージ W S T との間でウエハを搬送するウエハ搬送装置 8 8 とが収納されている。本実施形態では、これらウエハキャリア 8 4、ロボット 8 6 及びウエハ搬送装置 8 8 によって基板搬送系としてのウエハローダ系が構成され、このウエハローダ系が小部屋 2 0 に収納されている。そこで、以下においては、小部屋 2 0 をウエハローダ室 2 0 と呼ぶものとする。

【 0 0 5 0 】

なお、ウエハローダ系は、上記構成に限られるものではなく、例えば多関節型

図 1 図 2 図 3 図 4 図 5 図 6 図 7 図 8 図 9 図 10 図 11 図 12 図 13 図 14 図 15 図 16 図 17 図 18 図 19 図 20 図 21 図 22 図 23 図 24 図 25 図 26 図 27 図 28 図 29 図 30 図 31 図 32 図 33 図 34 図 35 図 36 図 37 図 38 図 39 図 40 図 41 図 42 図 43 図 44 図 45 図 46 図 47 図 48 図 49 図 50 図 51 図 52 図 53 図 54 図 55 図 56 図 57 図 58 図 59 図 60 図 61 図 62 図 63 図 64 図 65 図 66 図 67 図 68 図 69 図 70 図 71 図 72 図 73 図 74 図 75 図 76 図 77 図 78 図 79 図 80 図 81 図 82 図 83 図 84 図 85 図 86 図 87 図 88 図 89 図 90 図 91 図 92 図 93 図 94 図 95 図 96 図 97 図 98 図 99 図 100

【 0 0 5 1 】

上記露光室 1 6、レチクルローダ室 1 8、ウエハローダ室 2 0 は、ステンレス

(SUS)あるいはテフロン等の脱ガスの少ない素材から成る給気経路としての給気管路24及び伸縮可能な蛇腹状の接続部26を介して機械室14に接続されている。

【0052】

前記露光室16に収納された露光装置本体22は、ミラーM1、M2を含む照明光学系28、この照明光学系28の下方に配置された投影光学系PL、この投影光学系PLと照明光学系28とに間に配置され、マスクとしてのレチクルRを保持するレチクルステージRST、投影光学系PLの下方に配置され、基板としてのウエハWを保持するウエハステージWST、及び投影光学系PLを保持するとともにウエハステージWSTが搭載された本体コラム30等を備えている。

【0053】

照明光学系28は、ミラーM1、M2の他、オプチカルインテグレータ、視野絞り(いずれも図示省略)等を含み、これらの光学部材が不図示の照明系ハウジング内に所定の位置関係で収納されて成る。この照明光学系28は、不図示の引き回し光学系(リレー光学系)を介して不図示の光源としてのKrFエキシマレーザ(出力波長248nm)あるいはArFエキシマレーザ(出力波長193nm)等のエキシマレーザに接続されている。上記の引き回し光学系は、その少なくとも一部にビーム・マッチング・ユニットと呼ばれる、光源と照明光学系28との間の光軸調整用の光学系を含む。また、図示は省略されているが、照明光学系28が収納される照明系ハウジング、及び光源(本実施形態では上記エキシマレーザ)と照明光学系28との間に配置され、少なくとも一部にビーム・マッチング・ユニットを含む上記引き回し光学系が収納される筐体(鏡筒)は、それぞれ内部が不活性ガス(例えば窒素、ヘリウムなど)でパージされ、清浄度が極めて良好に維持されるようになっている。

【0054】

本実施形態では、照明系ハウジング、引き回し光学系、光源、及び照明光学系28を除く残りの一部(例えばウエハステージWSTなど)を露光室とは別の筐体内に配置しても良い。この場合、上記別の筐体は、露光室の内部に配置しても良

【0055】

【0056】

【 0 0 5 7 】

【 0 0 5 8 】

このようにして構成された露光装置本体 2 2 によると、不図示のエキシマレーザから出射されたパルス紫外光が、各種レンズやミラー等からなる照明光学系 2 8 で必要な大きさ、及び照度均一性に整形されて、所定のパターンが形成されたレチクル R を照明し、このレチクル R に形成されたパターンが投影光学系 P L を介してウエハステージ W S T 上に保持されたウエハ W 上の各ショット領域に縮小転写されるようになっている。

【 0 0 5 9 】

本実施形態では、ウエハ W として、その表面に感光剤としてポジ型の化学増幅型レジストが塗布されたものが使用される。

【 0 0 6 0 】

本体チャンバ 1 2 内の前記給気管路 2 4 の一端（機械室 1 4 側の端部）には、第 3 の化学物質除去フィルタとしてのケミカルフィルタ C F 3 が配置されている。給気管路 2 4 の他端側は、2 つに分岐され、その一方の分岐路 2 4 a はレチクルローダ室 1 8 に接続され、そのレチクルローダ室 1 8 側の噴き出し口の部分には、レチクルローダ室 1 8 内に流入する空気中のパーティクルを除去するエアフィルタとしての U L P A フィルタ（ultra low penetration air-filter）及びフィルタプレナムから成るフィルタボックス A F 1 が設けられている。また、レチクルローダ室 1 8 のフィルタボックス A F 1 と反対側には、リターン部 4 0 が設けられ、このリターン部 4 0 の外側の部分に排気経路としてのリターنداクト 4 2 の一端が接続され、このリターنداクト 4 2 の他端側は機械室 1 4 の底面の一部に接続されている。

【 0 0 6 1 】

前記分岐路 2 4 a には、更に分岐路 2 4 c が設けられ、この分岐路 2 4 c は、ウエハローダ室 2 0 に接続され、そのウエハローダ室 2 0 側の噴き出し口の部分には、ウエハローダ室 2 0 内に流入する空気中のパーティクルを除去するエアフ

ィルタボックス A F 2 が設けられている。また、ウエハローダ室 2 0 と反対側には、リターン部 4 4 が設けられ、このリターン部 4 4 のウエハローダ室 2 0 と反対側には、リターنداクト 4 2 に連通する排気口が設けられている。

【 0 0 6 2 】

また、前記他方の分岐路 2 4 b は、レチクルローダ室 1 8 の露光室 1 6 との境界部に形成された噴き出し口 9 0 のレチクルローダ室 1 8 側に配置された露光室 1 6 内に流入する空気中のパーティクルを除去するエアフィルタとしての U L P A フィルタ及びフィルタプレナムから成るフィルタボックス A F 3 に接続されている。そして、噴き出し口 9 0 から均一な気流がサイドフローにて露光室 1 6 の上部空間に送り込まれるようになっている。噴き出し口 9 0 が形成されたレチクルローダ室 1 8 と露光室 1 6 との境界部分には、図 1 の A - A 線断面図である図 2 に示されるように、レチクル搬送エリア 9 2 を除いて、その周囲に複数のフィルタボックス A F 3 が配置されている。

【 0 0 6 3 】

また、露光室 1 6 の底部の機械室 1 4 側には、リターン部 4 6 が設けられ、このリターン部 4 6 下方のチャンバ 1 2 底壁には、排気経路としてのリターンダクト 4 8 の一端側に連通する排気口が形成され、リターンダクト 4 8 の他端側は機械室 1 4 の底面の一部に接続されている。

【 0 0 6 4 】

前記機械室 1 4 底部の本体チャンバ 1 2 と反対側には、外気取り入れ口としての O A 口 5 0 が形成され、この O A 口 5 0 部分に対向して第 2 の化学物質除去フィルタとしてのケミカルフィルタ C F 2 が配置されている。本体チャンバ 1 2 内、特に露光室 1 6 内は、清浄度を保つために、外部に対して常に陽圧に保たれており、そのため本体チャンバ 1 2 の前面等や不図示のインラインインターフェイス部等から空気が外部に漏れており、この漏れ分の外気を取り入れるため、O A 口 5 0 が設けられている。また、本実施形態では、化学増幅型レジストのいわゆる T シェイプ対策のため等の目的で、O A 口 5 0 を介して装置内部に取り込まれ

め、ケミカルフィルタ C F 2 が設けられている部分に設けられている。

【 0 0 6 5 】

機械室 1 4 の高さ方向中央やや下側には、冷却装置としてのクーラー（ドライ

コイル) 5 2 が設けられている。このクーラー 5 2 の出口部分には、クーラー表面の温度を検出する第 1 温度センサ 5 4 が配置されている。この第 1 温度センサ 5 4 の検出値は、制御装置 7 0 (図 1 では図示せず、図 3 参照) に供給されている。

【 0 0 6 6 】

機械室 1 4 内の空気通路のクーラー 5 2 上方には、所定間隔を隔てて加熱装置としての第 1 ヒータ 5 6 が配置されている。この第 1 ヒータ 5 6 上方の機械室 1 4 の出口部分には、第 1 送風機 5 8 が配置されている。

【 0 0 6 7 】

また、機械室 1 4 内の空気通路の第 1 ヒータ 5 6 の下方には、クーラー 5 2 を下方から上方に通過した空気の約 1 / 5 が流れ込む分岐路 6 0 が設けられ、この分岐路 6 0 の機械室 1 4 側の端部は、伸縮可能な蛇腹状部材 6 0 a により構成されている。分岐路 6 0 の蛇腹状部材 6 0 a より機械室と反対側の部分は、露光室 1 6 内に配置されている。分岐路 6 0 内には、加熱装置としての第 2 ヒータ 6 2 、第 2 送風機 6 4 が順次配置され、この第 2 送風機 6 4 の機械室と反対側に、ウェハステージ W S T 近傍に対する空気の噴き出し口が形成され、この噴き出し口部分にケミカルフィルタ C F 4 、U L P A フィルタ及びフィルタプレナムから成るフィルタボックス A F 4 が配置されている。これらケミカルフィルタ C F 4 、フィルタボックス A F 4 が設けられた噴き出し口に対向して、露光室 1 6 のウェハローダ室 2 0 寄りの部分には、排気経路としてのリターンダクト 6 6 の一端側の開口端が配置され、このリターンダクト 6 6 の他端側は機械室 1 4 の底面の一部に接続されている。

【 0 0 6 8 】

前記 3 つのリターンダクト 4 2 、4 8 、6 6 が接続された機械室 1 4 の底面の一部には、開口が形成され、この開口部に対向して第 1 の化学物質除去フィルタ

は、機械室 1 4 内に設けられ、この図示の開閉扉を容易に開閉出来るようになっている。

【 0 0 6 9 】

本実施形態で用いられるケミカルフィルタCF1、CF2、CF3、CF4としては、クリーンルーム内に存在するアンモニアガス等の塩基性ガスの他、シロキサン、シラザン等のシリコン系の有機物、ハイドロカーบอนは勿論、可塑剤や難燃剤その他の化学的不純物をも除去するものが用いられている。具体的には、ケミカルフィルタCF1、CF2、CF3、CF4として活性炭フィルタ（例えば、ニッタ（株）製のギガソープ）やゼオライトフィルタが用いられる。

【 0 0 7 0 】

更に、機械室14内のクーラー52の下方には、ドレインパン68が配置されている。但し、このドレインパン68には、配管系は接続されていない。この理由については、後述する。

【 0 0 7 1 】

前記本体チャンバ12内の前記給気管路24の分岐部の機械室14寄りの部分には、給気管路24内部の空気の温度を検出する第2温度センサ72が配置されている。この第2温度センサ72の検出値は、制御装置70（図1では図示せず、図3参照）に供給されている。

【 0 0 7 2 】

また、ケミカルフィルタCF4の上流側には、第2送風機64から送り出される空気の温度を検出する第3温度センサ74が配置されている。この第3温度センサ74の検出値は、制御装置70（図1では図示せず、図3参照）に供給されている。

【 0 0 7 3 】

図3には、空調装置の温度制御に関連する制御系の構成が簡略化して示されている。この制御系は、マイクロコンピュータ（又はワークステーション）から構成される制御装置70を中心として構成されている。

【 0 0 7 4 】

まず、制御装置70により、第1、第2送風機58、64が作動され、これにより、フィルタボックスAF1、AF2、AF3、AF4をそれぞれ介してレチ

クルローダ室 1 8、ウエハローダ室 2 0、露光室 1 6 及び露光室 1 6 内のウエハステージ W S T 近傍に、空気が送り込まれ、前記各部の空調が行われる。この場合、レチクルローダ室 1 8、ウエハローダ室 2 0 内では、ダウンフローにより空調が行われる。また、露光室 1 6 内では、前述した露光動作中の露光装置本体 2 2 の各部の空調がサイドフローにより行われる。そして、リターン部 4 0、4 4 をそれぞれ介してリターنداクト 4 2 に戻された空気、リターン部 4 6 を介してリターنداクト 4 8 に戻された空気、及びリターنداクト 6 6 に戻された空気は、これらのリターنداクトの機械室 1 4 側の出口（本実施形態では機械室 1 4 の入口）部分に設けられたケミカルフィルタ C F 1 を通過する。このケミカルフィルタ C F 1 を通過中に、各リターنداクト内の空気に含まれる前述したような化学的不純物がケミカルフィルタ C F 1 によって吸着除去される。

【 0 0 7 6 】

そして、このケミカルフィルタ C F 1 を通過したケミカルクリーンな空気は、O A 口 5 0 を介して装置外から取り入れられ、ケミカルフィルタ C F 2 を通過したケミカルクリーンな空気と一緒に空調装置を構成するクーラー 5 2 によって所定温度まで冷却される。この場合において、本実施形態では、制御装置 7 0 により、第 1 温度センサ 5 4 の出力をモニタしつつ、クーラー 5 2 の冷却動作が制御され、この際、クーラー部分を通過する空気の湿度、圧力においてクーラー表面に結露が生じない程度の温度、例えば 5℃ より僅かに高い温度ないしは 1 5℃ 前後まで冷却される。このように、クーラー 5 2 表面には、結露が生じないので、本実施形態ではドレイン配管系を設けていない。但し、第 1 温度センサ 5 4 の故障や、クーラー 5 2 の何らかの不具合の発生により、上述したようなクーラー 5 2 の表面温度制御が困難となるおそれがある。そこで、本実施形態ではかかる非常事態を考慮して、ドレインパン 6 8 を設けているのである。

【 0 0 7 7 】

..... 送り込まれ、残りの空気は、..... 加熱回路の..... の第..... に送り込まれ、それぞれの目標温度まで加熱される。この場合、制御装置 7 0 では、第 2 温度センサ 7 2 の検出値に基づいて第 1 ヒータ 5 6 をフィードバック制

御するとともに、第3温度センサ74の検出値に基づいて第2ヒータ62をフィードバック制御する。この場合、給気管路24を介して露光室16等の内部に噴き出される空気の目標温度（温度制御範囲を含む）と、分岐路60を介してウエハステージWST近傍に噴き出される空気の目標温度（温度制御範囲を含む）とは、それぞれ個別に設定することができる。

【 0 0 7 8 】

そして、第 1、第 2 ヒータ 56、62 によりそれぞれの目標温度まで加熱された化学的に相当に清浄な空気は、第 1、第 2 送風機 58、64 により、ケミカルフィルタ CF3、CF4 にそれぞれ送り込まれる。そして、ケミカルフィルタ CF1 を通過した空気は、本体チャンバ 12 内の給気管路 24 及びフィルタボックス AF1、AF2、AF3 をそれぞれ介してレチクルローダ室 18、ウェハローダ室 20、露光室 16 内にそれぞれ送り込まれる。また、ケミカルフィルタ CF4 を通過した空気は、フィルタボックス AF4 を通過してウェハステージ WST 近傍に送り込まれる。

【 0 0 7 9 】

フィルタボックス A F 1、A F 2、A F 3、A F 4 内の U L P A フィルタをそれぞれ通過することにより、空気中のパーティクルがほぼ確実に除去されるので、レチクルローダ室 1 8、ウエハローダ室 2 0、露光室 1 6 内及びウエハステージ W S T 近傍には、パーティクル及び化学的不純物等の微小粒子を含まないという意味で清浄度の高い空気のみが供給され、この正常な空気によってレチクルローダ系、ウエハローダ系、露光装置本体 2 2 が空調される。そして、この空調が終了し、露光装置本体 2 2 等からの脱ガスに起因する化学的不純物を含む化学的に汚れた空気が、リターンダクト 4 2、4 8、6 6 内に戻され、以後、上述したようにして各部の空調が繰り返行われる。

【 0 0 8 0 】

部分に第 1 の化学物質除去フィルタとしてのケミカルフィルタ C D 1 が配置されていることから、露光装置本体 2 2、レチクルローダ系、ウエハローダ系等で発

生した脱ガスに起因する化学的な汚染物質をケミカルフィルタ C F 1 でほぼ確実に除去することができる。

【 0 0 8 1 】

また、ケミカルフィルタ C F 1 は、本体チャンバ 1 2 から機械室 1 4 に戻る排気経路の内、機械室側の出口部分（機械室の入り口部分）に配置され、この部分に不図示の開閉扉が設けられているので、この開閉扉部分からケミカルフィルタ C F 1 の交換を簡単に行うことができる。

【 0 0 8 2 】

また、本実施形態では、機械室 1 4 には、O A 口 5 0 が設けられ、該 O A 口 5 0 の内側には、第 2 の化学物質除去フィルタとしてのケミカルフィルタ C F 2 が設けられているので、結果的に化学的にクリーンな外気が装置内に取り入れられることとなり、装置内のクリーン度を低下させることがない。このため、本体チャンバ 1 2 内を外気に対して陽圧にして清浄度を高く保つことが可能である。

【 0 0 8 3 】

また、本実施形態では、機械室 1 4 から本体チャンバ 1 2 内の給気管路 2 4 に至る経路の一部に第 3 の化学物質除去フィルタとしてのケミカルフィルタ C F 3 が配置されていることから、機械室 1 4 内の空調装置により温度調整された空気を、露光装置本体 2 2 が収納された露光室 1 6 に送り込むのに先立って、再度その空気中の化学的な汚染物質を除去できるので、より一層化学的に清浄度の高い（ケミカルクリーンな）空気により露光装置本体 2 2 を空調でき、本体チャンバ 1 2 内を一層クリーンな状態にすることができる。また、ケミカルフィルタ C F 3 には、ケミカルフィルタ C F 1 及びケミカルフィルタ C F 2 で化学的な汚染物質が除去されたケミカルクリーンな空気が送り込まれるので、その寿命が長くなり、長期間に渡って交換が不要である。但し、ケミカルフィルタ C F 3 は、機械室 1 4 と本体チャンバ 1 2 内の給気管路 2 4 との接続部 2 6 の近傍に配置されて

図 1 図 2 図 3 図 4 図 5 図 6 図 7 図 8 図 9 図 10 図 11 図 12 図 13 図 14 図 15 図 16 図 17 図 18 図 19 図 20 図 21 図 22 図 23 図 24 図 25 図 26 図 27 図 28 図 29 図 30 図 31 図 32 図 33 図 34 図 35 図 36 図 37 図 38 図 39 図 40 図 41 図 42 図 43 図 44 図 45 図 46 図 47 図 48 図 49 図 50 図 51 図 52 図 53 図 54 図 55 図 56 図 57 図 58 図 59 図 60 図 61 図 62 図 63 図 64 図 65 図 66 図 67 図 68 図 69 図 70 図 71 図 72 図 73 図 74 図 75 図 76 図 77 図 78 図 79 図 80 図 81 図 82 図 83 図 84 図 85 図 86 図 87 図 88 図 89 図 90 図 91 図 92 図 93 図 94 図 95 図 96 図 97 図 98 図 99 図 100

図 1 図 2 図 3 図 4 図 5 図 6 図 7 図 8 図 9 図 10 図 11 図 12 図 13 図 14 図 15 図 16 図 17 図 18 図 19 図 20 図 21 図 22 図 23 図 24 図 25 図 26 図 27 図 28 図 29 図 30 図 31 図 32 図 33 図 34 図 35 図 36 図 37 図 38 図 39 図 40 図 41 図 42 図 43 図 44 図 45 図 46 図 47 図 48 図 49 図 50 図 51 図 52 図 53 図 54 図 55 図 56 図 57 図 58 図 59 図 60 図 61 図 62 図 63 図 64 図 65 図 66 図 67 図 68 図 69 図 70 図 71 図 72 図 73 図 74 図 75 図 76 図 77 図 78 図 79 図 80 図 81 図 82 図 83 図 84 図 85 図 86 図 87 図 88 図 89 図 90 図 91 図 92 図 93 図 94 図 95 図 96 図 97 図 98 図 99 図 100

【 0 0 8 4 】

また、機械室 1 4 内部の空気の通路に分岐路 6 0 が設けられ、この分岐路 6 0

を介してウェハ表面近傍を他の部分とは独立して空調を行うようになっていることから、ウェハステージW S Tの位置を計測する干渉計I Fの計測値に空気揺らぎに起因する計測誤差が発生するのを効果的に防止することができ、特に精度が要求されるウェハステージW S Tの位置制御を要求される精度で実現することができる。また、このウェハ表面近傍の空調のための空気もケミカルフィルタC F 4を通過した化学的に清浄な空気が用いられるので、化学増幅型レジストの表面難溶化現象が生じるのを効果的に抑制することができる。

【 0 0 8 5 】

同様に、化学的な不純物の影響を受け易い化学増幅型レジストが塗布されたウェハが通過する空間であるウェハローダ室2 0内にもケミカルクリーンな空気が供給されるので、この部分においても化学増幅型レジストの表面難溶化現象が生じるのを効果的に抑制することができる。

【 0 0 8 6 】

また、本体チャンバ1 2内の給気管路2 4の露光室1 6、レチクルローダ室1 8及びウェハローダ室2 0に対する空気の噴き出し口及びウェハ表面に対する空気噴き出し口の近傍には、パーティクル除去用のU L P Aフィルタを内蔵するフィルタボックスが設けられていることから、露光装置1 0をクリーン度がクラス1 0 0 ~ 1 0 0 0程度の比較的クリーン度の低いクリーンルーム内に設置しても装置内のクリーン度をクラス1程度に維持できるので、クリーンルームの維持コストを低減することができる。

【 0 0 8 7 】

また、ケミカルフィルタC F 3より下流の給気管路2 4の少なくとも内壁部分は、S U Sあるいはテフロン等の脱ガスの少ない素材によって形成されていることから、ケミカルフィルタC F 3より下流の給気管路部分で脱ガスが殆ど生じないので、真にケミカルクリーンな空気を露光装置本体2 2が収納された露光室1

【 0 0 8 8 】

また、本実施形態では、ケミカルフィルタC F 1 ~ C F 4として、活性炭フ

ルタあるいはゼオライトフィルタが用いられているので、通常クリーンルーム内及び露光装置内で生じる化学的不純物の殆ど全てを除去可能である。すなわち、チャンバ内や、投影光学系及び照明光学系における光学素子間の空間内に存在する不純物として、シロキサン（ $\text{Si}-\text{O}$ の鎖が軸の物質）あるいはシラザン（ $\text{Si}-\text{N}$ の鎖が軸の物質）等のシリコン系の有機物が問題となる。これを更に詳述すると、シロキサンは、 $\text{Si}-\text{O}$ の鎖が輪となった「環状シロキサン」という物質が、投影露光装置で用いられる接着剤、シーリング剤、塗料等に含まれており、これが経年変化により、脱ガスとして発生する。環状シロキサンは、シリコンウエハ等の半導体基板表面やレンズ等の誘電体表面に良く付着することが知られており、さらに紫外光（UV光）が当たると、酸化されて、光学素子表面における珪素酸化物の曇りの原因となる。

【 0 0 8 9 】

また、シラザンには、多くのユーザがレジスト塗布の工程で用いている前処理剤として、 Si の数が2個のHMD S（ヘキサ・メチル・ジ・シラザン）がある。HMD Sは、水と反応するだけでシラノールという、半導体基板の表面又は誘電体表面に非常に付着し易い物質に変化（加水分解）し、さらに、紫外光が当たると、シロキサンと同様に酸化されて、光学素子表面における珪素酸化物系の曇りの原因となる。なお、シラザンは上記加水分解でアンモニアを発生するが、このアンモニアがシロキサンと共存すると更に光学素子表面を曇り易くする。

【 0 0 9 0 】

これらシロキサンやシラザン等のシリコン系の有機物を、本実施形態のケミカルフィルタでは除去することができる。

【 0 0 9 1 】

また、Kr Fエキシマレーザ光やAr Fエキシマレーザ光あるいはそれより短波長の光を露光用照明光として用いる投影露光装置では、いわゆる光洗浄により

露光装置の内部に付着した有機物等が除去される。この除去された有機物は、排気中を排気されることになるが、この有機物も本実施形態のケミカルフィルタにより除去することができる。

【 0 0 9 2 】

また、現在では、シリコン系の不純物だけでなく、チャンバ内にある配線やプラスチック等の脱ガスとして、可塑剤（フタル酸エステルなど）、難燃剤（燐酸、塩素系物質）なども不純物として問題となりつつあるが、これら可塑剤や難燃剤等も上記活性炭フィルタにより除去することができる。

【 0 0 9 3 】

また、本実施形態の露光装置 1 0 では、制御装置 7 0 によりクーラー 5 2 の表面温度が結露が発生しない程度の温度に制御されるので、空調装置のドレイン配管系が不要となり、ドレイン配管系があることに起因する先に述べた a. ～ d. のような不具合の発生を阻止することができる。

【 0 0 9 4 】

以上詳細に説明したように、本実施形態の露光装置 1 0 によると、長期間に渡って機械室 1 4 及び本体チャンバ 1 2 内をケミカルクリーンな状態とすることができ、長期に渡って光学材料の曇りによる照度低下等の弊害の発生を効果的に抑制することができ、しかも化学増幅型レジストの表面難溶化現象を低減することができるという効果がある。

【 0 0 9 5 】

また、本実施形態の露光装置 1 0 では、レチクルローダ室 1 8 内の露光室 1 6 との境界部分に、露光室 1 6 内の上部空間をサイドフローにて送風するための空調用気体の噴き出し口 9 0 が設けられていることから、露光室 1 6 の前後左右の 4 面の内、噴き出し口 9 0 が設けられた面以外の 3 面側から露光室 1 6 内の露光装置本体 2 2 のメンテナンスが可能である（機械室 1 4 側は機械室 1 4 を取り除くことによりこの方向からメンテナンスが可能である）。また、露光室 1 6 内は、サイドフローにて空調されるので、露光室の天井部分に除塵用フィルタ（エアフィルタ）やケミカルフィルタ、及び除塵用フィルタのプレナム・ダクトを設置

る。従って、従来に比べて、実際には、この給気管路 2 1 は、露光室 1 6 の天井面全面でなくその一部のスペースのみを占有するに過ぎないので、照明光学系 2 8 の横の空きスペースに給気管路 2 1 を十分に配置することができ、このよう

にすれば、従来のダウフロー方式の露光装置に比べて装置の全高を大幅に低くすることができる。従って、本実施形態の露光装置 10 によると、良好なメンテナンス性を確保しつつ、装置全高を低くすることができる。また、露光室の天井部分に給気経路のみを設けてダウフローするようにしても良く、この場合でも装置全高を低くすることが可能である。

【 0 0 9 6 】

なお、上記実施形態では、リターンダクトの機械室側の端部に設けられたケミカルフィルタの他に、O A 口部分、本体チャンバ内の給気管路の機械室側の入り口部分及びウエハ表面に対する空気の噴き出し口近傍にもケミカルフィルタを設ける場合について説明したが、本発明がこれに限定されることはなく、少なくともリターンダクト内の一部にケミカルフィルタを設けるのみでも、長期に渡って光学材料の曇りによる照度低下等の弊害の発生を効果的に抑制するという本発明の目的はある程度達成される。

【 0 0 9 7 】

また、上記実施形態ではリターンダクトの機械室側の端部にケミカルフィルタを設け、クーラーの表面温度を結露が生じない程度の温度に制御する場合について説明したが、これらの内、いずれか一方のみによっても長期に渡って光学材料の曇りによる照度低下等の弊害の発生を効果的に抑制することは可能である。勿論、図 1 に示される空調機構や経路との組み合わせも必須ではなく、その構成は任意で構わない。

【 0 0 9 8 】

また、上記実施形態ではレチクルローダ室、ウエハローダ室と露光室とが本体チャンバ内に設けられる場合について説明したが、これに限らず、本体チャンバ内に露光室のみを設け、レチクルローダ室、ウエハローダ室を別の環境制御チャンバ内に一緒あるいはそれぞれ単独に設けても良い。

上記実施形態では、本体チャンバ内に露光装置 10 の機械室が設けられる場合について説明したが、これに限らず、1 つのチャンバを隔壁により仕切って露光装置本体が収納される本体チャンバと機械室とを形成しても良い。

【 0 1 0 0 】

なお、図 1 では本体チャンバに隣接して機械室を配置するものとしたが、クリーンルームの床下（ユーティリティスペース）などに機械室を配置するようにしても良い。この場合、光源もその床下に配置しても良い。また、空調機では空気の温度を制御するものとしたが、それに加えて湿度及び圧力の少なくとも一方を制御するようにしても良い。

【 0 1 0 1 】

また、ArFエキシマレーザー光（波長 1 9 3 n m）を露光用照明光として用いる場合には、照明光学系 2 8 と同様に、投影光学系 P L の鏡筒内、あるいは投影光学系 P L を収納する筐体内にも不活性ガス（窒素など）が供給される。さらに、F₂レーザー光（波長 1 5 7 n m）を露光用照明光として用いる場合には、レチクルステージ及びウエハステージがそれぞれサブチャンバ内に配置され、照明光学系 2 8 及び投影光学系 P L に加えて、照明光学系 2 8 と投影光学系 P L との間、及び投影光学系 P L とウエハ W との間にもそれぞれ不活性ガス（ヘリウムなど）が供給される。従って、光源内を含めてその光源からウエハ W に至る照明光路の少なくとも一部を密閉してその内部に不活性ガスなどを供給する露光装置では、例えば照明光学系に供給された不活性ガスが通る排気経路の途中、又は出口にも、前述のケミカルフィルタを設けておくことが好ましい。勿論、不活性ガスの流入経路の途中又は入り口にもケミカルフィルタを設けても良く、これは特に回収した不活性ガスを清浄化して再利用する場合に有効である。また、上述のように、例えば波長 1 2 0 n m ～ 2 0 0 n m 程度の真空紫外域に属する光を露光用照明光として用いる場合などには、空調用気体として上記不活性ガス（窒素ガス、ヘリウムガスなど）が用いられる。従って、本発明の空調装置は、不活性ガスを循環させる空調装置をも含むものである。

【 0 1 0 2 】

なお、図 1 の露光装置 1 0 0 において、光源 1 0 1 として、エキシマレーザー、F₂レーザー、金属蒸気レーザー、YAGレーザー、またはファイバレーザーを用いても良く、あるいは金属蒸気レーザーや YAG レーザーを用い、これらの高調波を露光用照明光としても良い。あるいは、DFB 半導体レーザー又はファイバ

ーレーザから発振される赤外域、又は可視域の単一波長レーザ光を、例えばエルビウム（E r）（又はエルビウムとイッテルビウム（Y b）の両方）がドープされたファイバーアンプで増幅し、非線形光学結晶を用いて紫外光に波長変換した高調波を、露光用照明光として用いても良い。

【 0 1 0 3 】

また、本発明はステップ・アンド・リピート方式、ステップ・アンド・スキャン方式、又はステップ・アンド・ステッチ方式の露光装置だけでなく、例えばミラープロジェクション・アライナー、プロキシミティ方式の露光装置、及びフォトリピータなどにも適用することができる。即ち、露光装置本体の構成などに関係なく、空調機を有する露光装置であれば本発明を適用できる。

【 0 1 0 4 】

《デバイス製造方法》

次に、上述した露光装置をリソグラフィ工程で使用したデバイスの製造方法の実施形態について説明する。

【 0 1 0 5 】

図4には、デバイス（I CやL S I等の半導体チップ、液晶パネル、C C D、薄膜磁気ヘッド、マイクロマシン等）の製造例のフローチャートが示されている。図4に示されるように、まず、ステップ2 0 1（設計ステップ）において、デバイスの機能・性能設計（例えば、半導体デバイスの回路設計等）を行い、その機能を実現するためのパターン設計を行う。引き続き、ステップ2 0 2（マスク製作ステップ）において、設計した回路パターンを形成したマスクを製作する。一方、ステップ2 0 3（ウエハ製造ステップ）において、シリコン等の材料を用いてウエハを製造する。

【 0 1 0 6 】

次に、ステップ2 0 4（ウエハ処理ステップ）において、ステップ2 0 1～ス

技術者により、ステップ2 0 2に実際の回路等を形成する。次いで、ステップ2 0 3

5（デバイス組立ステップ）において、ステップ2 0 4で処理されたウエハを用いてデバイス組立を行う。このステップ2 0 5には、ダイシング工程、ボンディ

ング工程、及びパッケージング工程（チップ封入）等の工程が必要に応じて含まれる。

【 0 1 0 7 】

最後に、ステップ 2 0 6（検査ステップ）において、ステップ 2 0 5 で作製されたデバイスの動作確認テスト、耐久性テスト等の検査を行う。こうした工程を経た後にデバイスが完成し、これが出荷される。

【 0 1 0 8 】

図 5 には、半導体デバイスの場合における、上記ステップ 2 0 4 の詳細なフロー例が示されている。図 5 において、ステップ 2 1 1（酸化ステップ）においてはウエハの表面を酸化させる。ステップ 2 1 2（CVD ステップ）においてはウエハ表面に絶縁膜を形成する。ステップ 2 1 3（電極形成ステップ）においてはウエハ上に電極を蒸着によって形成する。ステップ 2 1 4（イオン打込みステップ）においてはウエハにイオンを打ち込む。以上のステップ 2 1 1～ステップ 2 1 4 それぞれは、ウエハ処理の各段階の前処理工程を構成しており、各段階において必要な処理に応じて選択されて実行される。

【 0 1 0 9 】

ウエハプロセスの各段階において、上述の前処理工程が終了すると、以下のようにして後処理工程が実行される。この後処理工程では、まず、ステップ 2 1 5（レジスト形成ステップ）において、ウエハに感光剤を塗布する。引き続き、ステップ 2 1 6（露光ステップ）において、上で説明した露光装置によってマスクの回路パターンをウエハに転写する。次に、ステップ 2 1 7（現像ステップ）においては露光されたウエハを現像し、ステップ 2 1 8（エッチングステップ）において、レジストが残存している部分以外の部分の露出部材をエッチングにより取り去る。そして、ステップ 2 1 9（レジスト除去ステップ）において、エッチングが済んで不要となったレジストを取り除く。

以上一前処理工程、後処理工程、を繰り返して、図 5 のように、多重に回路パターンが形成される。

【 0 1 1 1 】

以上説明した本実施形態のデバイス製造方法を用いれば、露光工程（ステップ 2 1 6）において上記実施形態の露光装置 1 0 が用いられるので、長期に渡って光学材料の曇りによる照度低下等の弊害の発生を効果的に抑制することができ、これにより高いスループットを維持して高集積度のデバイスを生産性良く製造することができる。

【 0 1 1 2 】

【発明の効果】

以上説明したように、請求項 1 ～ 1 0 に記載の各発明によると、光学材料の曇りによる照度低下等の弊害の発生を長時間に渡って効果的に抑制することができるという優れた効果がある。

【 0 1 1 3 】

また、請求項 1 1 ～ 1 7 に記載の各発明によると、メンテナンス性を維持しつつ装置全高の高さを低くすることができるという効果がある。

【 0 1 1 4 】

また、請求項 1 8 に記載の発明によると、高集積度のマイクロデバイスを生産性良く製造することができるという効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

一実施形態に係る露光装置の全体構成を概略的に示す図である。

【図 2】

図 1 の A - A 線断面図である。

【図 3】

図 1 の露光装置の温度制御に関連する制御系を概略的に示すブロック図である。

【図 4】

図 4 のステップ 2 0 1 における処理を示すフローチャートである。

【図 5】

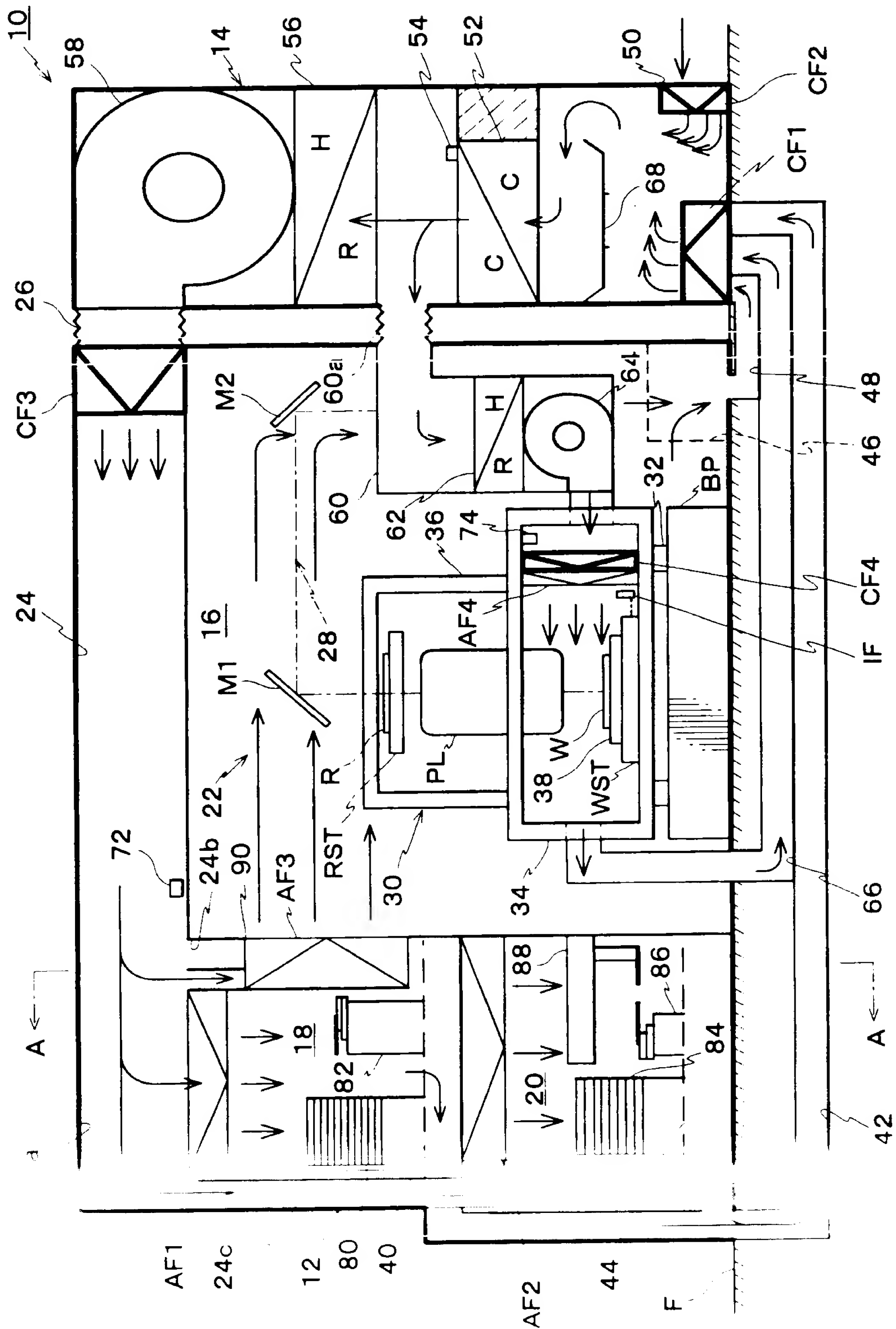
図 4 のステップ 2 0 1 における処理を示すフローチャートである。

【符号の説明】

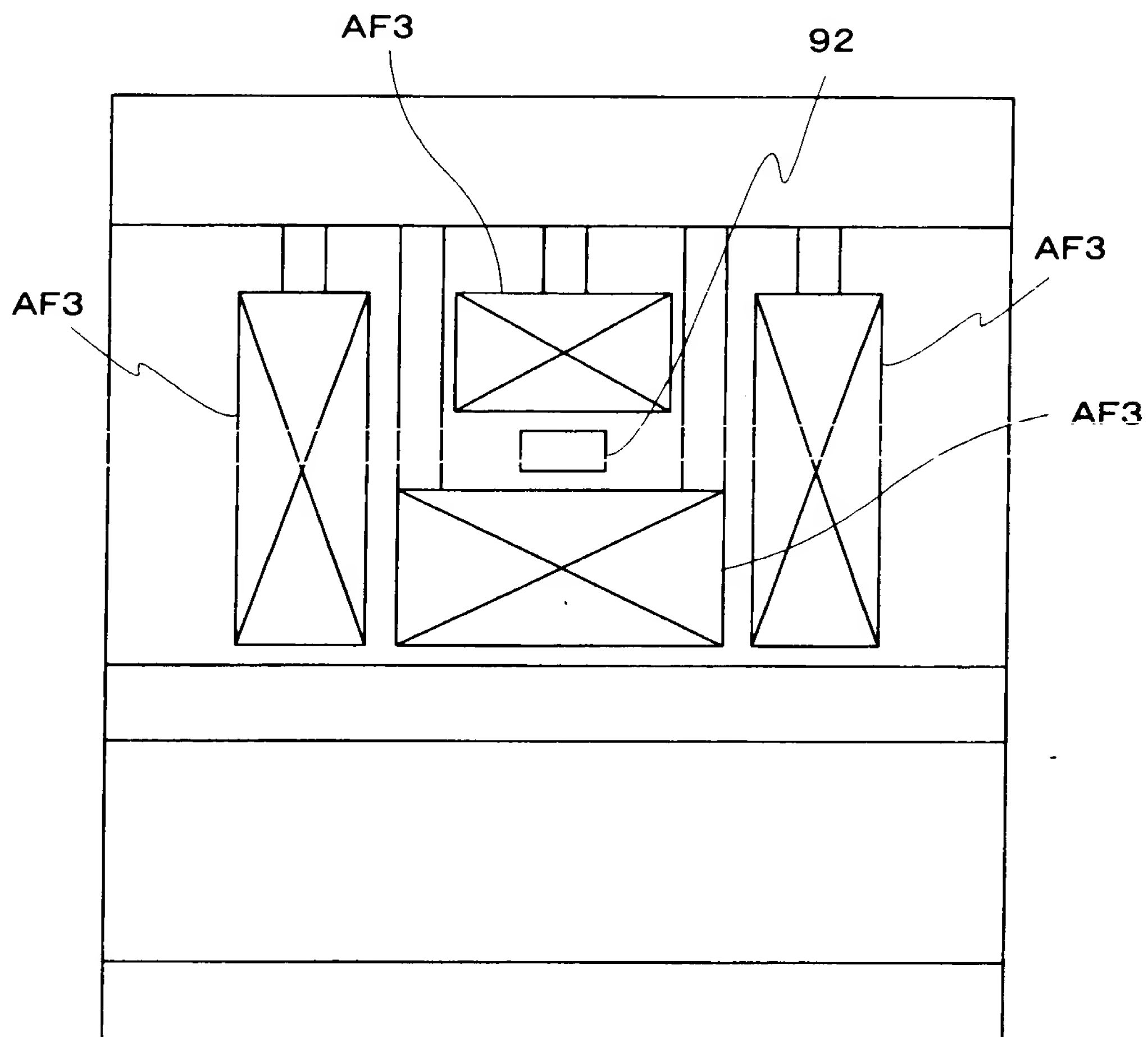
1 0 …露光装置、1 2 …本体チャンバ、1 4 …機械室、1 6 …露光室、1 8 …レチクルローダ室（マスク搬送系収納室）、2 0 …ウエハローダ室（基板搬送系収納室）、2 2 …露光装置本体、4 2 …リターンダクト（排気経路）、4 8 …リターンダクト（排気経路）、5 0 …OA口（外気取り入れ口）、5 2 …クーラー（冷却装置、空調装置の一部、別の空調装置の一部）、5 6 …第1ヒータ（加熱装置、空調装置の一部）、5 8 …第1送風機（空調装置の一部）、6 2 …第2ヒータ（加熱装置、別の空調装置の一部）、6 4 …第2送風機（別の空調装置の一部）、6 6 …リターンダクト（排気経路）、7 0 …制御装置、8 0 …レチクルライブラリ（マスク搬送系の一部）、8 2 …レチクルローダ（マスク搬送系の一部）、8 4 …ウエハキャリア（基板搬送系の一部）、8 6 …ロボット（基板搬送系の一部）、8 8 …基板搬送装置（基板搬送系の一部）、W…ウエハ（基板）、CF 1 …ケミカルフィルタ（第1の化学物質除去フィルタ）、CF 2 …ケミカルフィルタ（第2の化学物質除去フィルタ）、CF 3 …ケミカルフィルタ（第3の化学物質除去フィルタ）、AF 1 ～AF 4 …フィルタボックス（エアフィルタ）。

【書類名】 図面

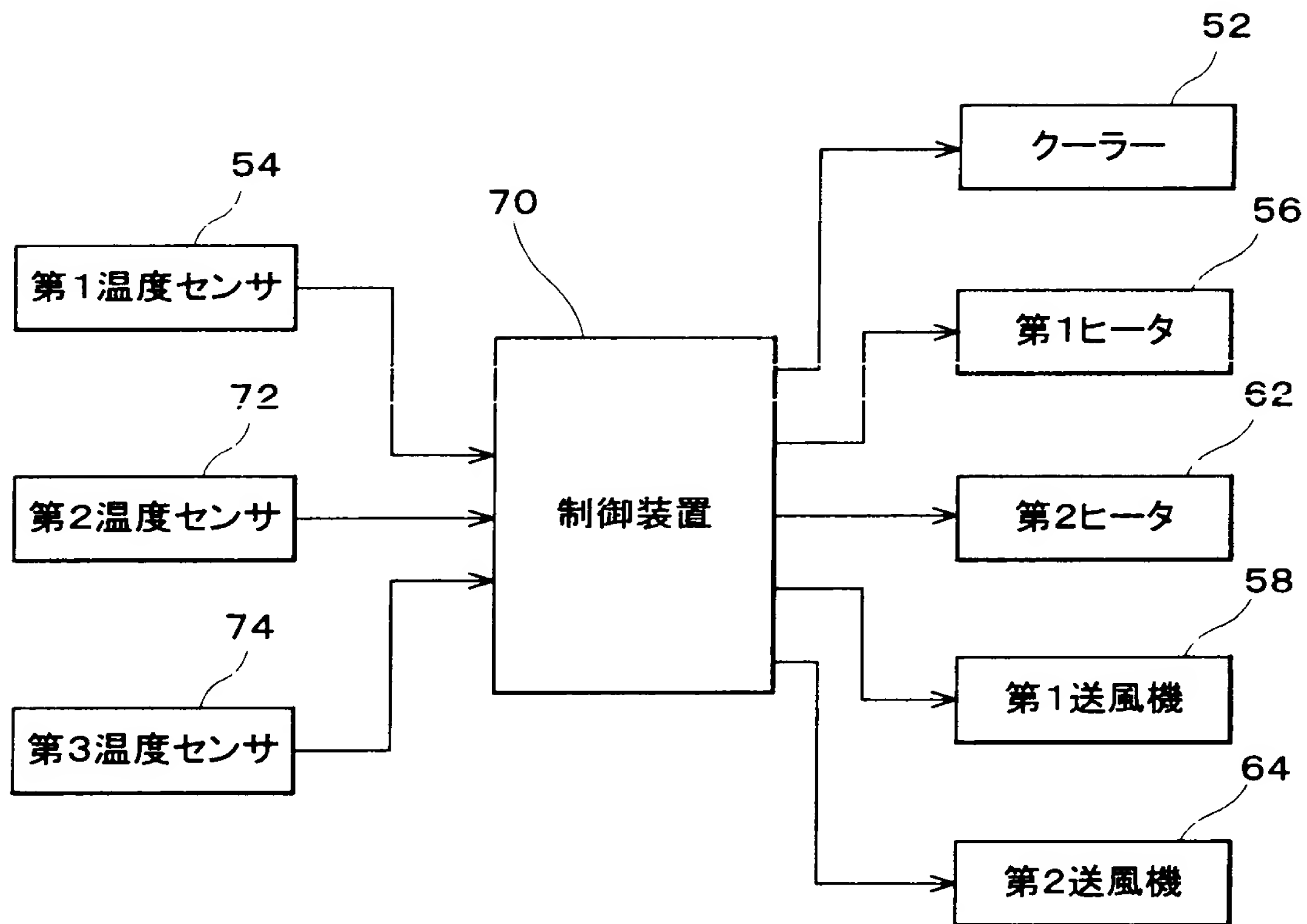
【図1】



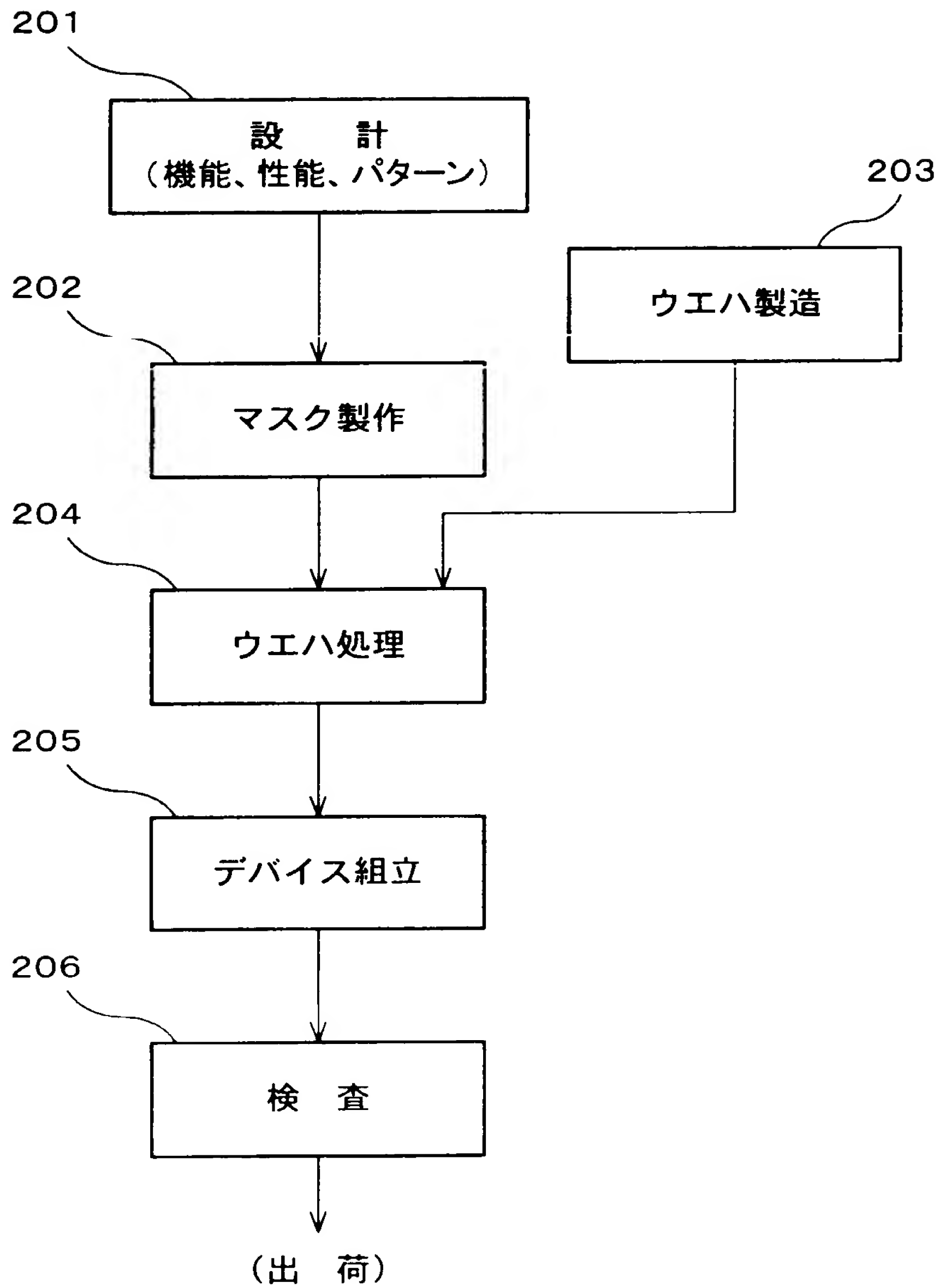
【図2】



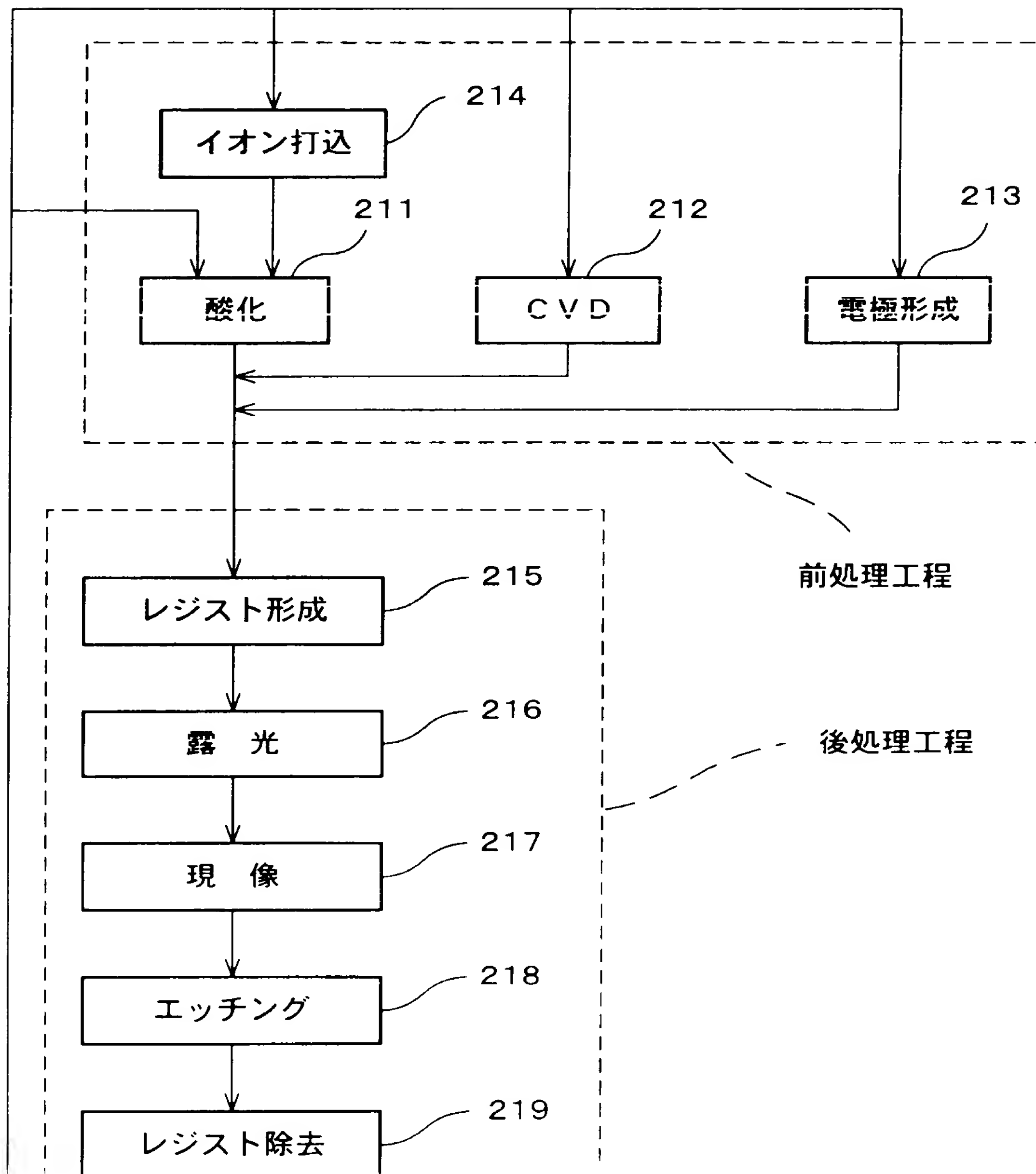
【図 3】



【図 4】



【図 5】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 光学材料の曇りによる照度低下等の弊害の発生を長時間に渡って効果的に抑制する。

【解決手段】 本体チャンバ 1 2 から機械室 1 4 に戻る排気経路の一部にケミカルフィルタ C F 1 が配置されている。このため、露光装置本体 2 2 で発生した脱ガスに起因する汚染物質をケミカルフィルタ C F 1 でほぼ確実に除去することができ、しかもこのケミカルフィルタ C F 1 は本体チャンバ 1 2 から機械室 1 4 に戻る排気経路の機械室側の端部に配置されているので、非常に交換が容易である。従って、本体チャンバ 1 2 内を化学的に清浄度の高い状態（ケミカルクリーンな状態）に保つことができ、これにより光学材料の曇りによる照度低下等の弊害の発生を長時間に渡って効果的に抑制することが可能になる。

【選択図】 図 1

特 2 0 0 0 - 0 4 8 6 7 0

認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2 0 0 0 - 0 4 8 6 7 0
受付番号	5 0 0 0 0 2 1 6 9 9 6
書類名	特許願
担当官	第五担当上席 0 0 9 4
作成日	平成 1 2 年 3 月 1 日

< 認定情報・付加情報 >

【提出日】 平成12年 2月25日

次頁無

特 2 0 0 0 - 0 4 8 6 7 0

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [0 0 0 0 0 4 1 1 2]

1. 変更年月日 1 9 9 0 年 8 月 2 9 日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都千代田区丸の内 3 丁目 2 番 3 号

氏 名 株式会社ニコン